



Rev: 1

日期: 2015.03.19

## 简介

**Qmega QSP628** 是应用在表面粘接及其它电子连装的一种低残留、不含卤素的免清洗锡膏。对客户来说是比较常用、比较经济的锡膏。这种锡膏可以用在小至 20 mil 间距的印刷。其长久、良好的粘力，可适应高速印刷和粘贴。其助焊剂配方具有卓越的活性和可靠性。回流焊之后，助焊剂残留是透明的，对线路无腐蚀、无短路、高表面绝缘阻抗。因其助焊剂的独特配方，使其具有较长的保质期和较宽松的储存环境要求。

## 优势

- 符合无卤素要求 (Cl<900ppm,Br<900ppm,Cl+Br<1500ppm)
- 长时间的钢网使用寿命
- 长时间的粘着力保持
- 良好的存储稳定性
- 卓越的润湿性能
- 低空洞
- 基本上没有锡珠与锡球

## 应用

### 网板印刷

>31mil 间距 用 -200+325 目

<30mil 间距 用 -325+500 目

<20mil 间距 用 -400+635 目

### 合金

Sn62.8Pb36.8Ag0.4

(根据 J-STD-006 标准)

### 金属含量

钢网印刷: 89.0-90.5%

### 粘力

粘贴时间 >24 小时 (89.5-90.5% 金属)

### 推荐刮印参数

#### 刮刀片

硬度为 80 - 90 度 (肖氏) 的聚氨酯或不锈钢

#### 刮印速度

一般为 1.0 - 8.0 in/sec (25 -200 mm/sec), 其他亦可

## 网板材料

不锈钢、黄铜、聚氨酯。

## 物理、化学特性

颜色和外观:	金属光泽
铜镜测试 (助焊剂):	通过
铬酸银试纸测试 (助焊剂):	通过 (氯化物、溴化物测试)
粘度 Malcom (测试仪)	100 - 300 Pa.S, 89.0-90.5% 金属 (-325+500 目)
电子迁移, Bellcore	通过
表面绝缘阻抗 ( $\Omega$ ) *	Bellcore4 2.09 x 10 <sup>9</sup> ohms (4 days, 35°C, 85% R.H.) J-STD-004 5.06 x 10 <sup>9</sup> ohms (7 days, 85°C, 85% R.H.)
粘着力	Time 48 Hours (JIS Z 3284) Initial tack force 114.9 grams (JIS Z 3284) Tack retention after 24 hours 95.6 grams (JIS Z 3284)

## 坍塌测试

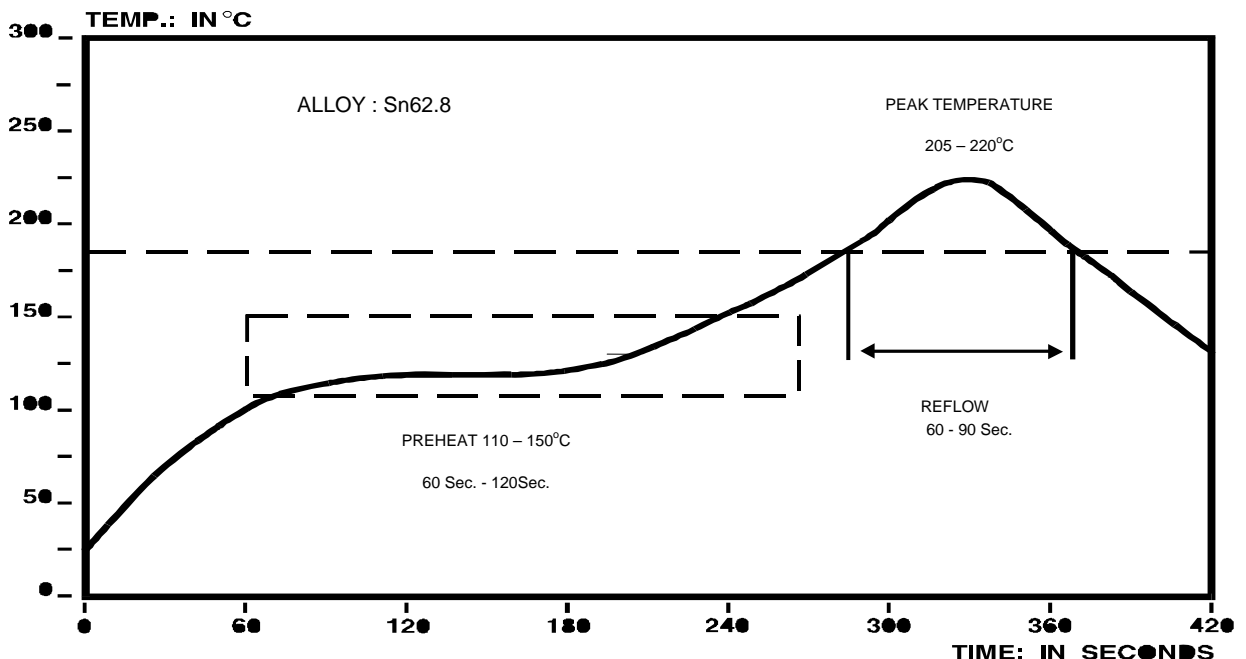
25 C, 0.63 vertical/horizontal	No bridges all spacings	IPC-TM-650 2.4.35
150 C, 0.63 vertical/horizontal	No bridges all spacings	IPC-TM-650 2.4.35
25 C, 0.33 vertical/horizontal	0.15 /0.15	IPC-TM-650 2.4.35
150 C, 0.33 vertical/horizontal	0.20/0.20	IPC-TM-650 2.4.35

## 回流曲线图

回流曲线图取决于焊锡料的熔点和元件的抗热性。

以下为推荐回流曲线图(详见: Profile Using Sn62.8Pb36.8Ag0.4):

**QSP628** 可用于多种回流设备 (如红外、汽相、热风对流、激光定点加热等等), 理想的升温速度是 2.5 - 3.0°C/sec (多数元件升温速度极限为 4.0°C/sec)。



## 存储

建议将锡膏存储在 35-50 F (2-10 C)的环境中，以减少溶剂的挥发、助焊剂的析出、化学反应。如果存放在室内，则温度应。如果存放在室内，则温度应保持在 68-77F (20-25 C)。

## 使用期

6个月（未开罐、2-10℃保存、从生产日期算起）

## 回收锡膏的使用

建议不要将用剩下的锡膏重新回收利用，因为这样做常常会带来很多问题。如果必须这样做，以下建议会有帮助：Qualitek 建议，首先将用过的锡膏回收到一个空容器内密封冷藏保存，不要与新鲜锡膏混在一起。然后尽快用完，以免锡膏分层或变稠。如果不影响印刷性能，则锡膏可以继续使用；如果印刷出现问题，则将回收的锡膏丢弃。也可以将 50%的旧锡膏与 50%的新鲜锡膏混合搅拌均匀后使用，以获得最佳的使用性能。

## 使用环境

锡膏在一个受控的环境中应用性能表现优异。保持环境温度在 68-77 F (20-25 C)、湿度在 40-65%，以确保锡膏保持一致的性能和延长锡膏的使用寿命。

## 清洗印刷问题板

建议在生产过程中定期清洁钢网，以防止多余的锡膏污染板面。如果不定期清洁钢网，锡珠问题将会增多。将建议定期干擦（每 5-10 块板）偶尔湿擦（每 15-25 块板）。如果生产细间距板，则需更加频繁的清洁钢网。湿擦建议用 IPA 或 Qualitek 的钢网清洗剂：SK-11。生产结束后，要彻底清洗钢网。如果具有钢网清洗设备，建议使用 Qualitek 的 SK-44 钢网清洗剂。

## 处置

**QSP628** 须存放在密封的容器内，按照国家或地方法规处置。

## 包装

35 g

120 g

200 g

250 g

500 g

以上资料生产厂家 QUALITEK 相信是精确并可靠的，但并不明确或暗示地保证此资料的精确。在超出 QUALITEK 所控制的产品应用的方法和条件下，QUALITEK 不对因使用此资料而造成的损失承担责任。故在产品商品化以前，用户应确定产品的可用性。QUALITEK 的保证仅限于对产品本身的概述。

修订日期：2015年03月19日

修订人：高萍